

证券代码：688037

证券简称：芯源微

沈阳芯源微电子设备股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-02

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	参与公司网上2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的投资者
时间	2026年6月5日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长 董博宇先生 董事、执行委员会主席 邓晓军先生 执行委员会委员、副总裁、财务总监 张新超先生 执行委员会委员、副总裁、董事会秘书 刘书杰先生 独立董事 潘伟先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司 2025 年及 2026 年第一季度经营情况</p> <p>尊敬的各位投资者、各位朋友们，大家上午好！欢迎大家参加芯源微 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会。非常感谢各位投资者朋友们对公司长期以来的关注和支持，同时也感谢上证路演中心对本次业绩说明会提供的技术支持和帮助。</p> <p>2025 年度，公司实现营业收入 19.48 亿，同比增长 11%。从收入构成来看，化学清洗首次贡献收入，后续随着持续签单及交验节奏加快，预计化学清洗在收入中的占比也将持续提升；后道及小尺寸收入占比基本持平，其中键合品</p>

类收入规模及占比大幅提升；前道 Track 收入规模有所增长，随着新机型陆续推出并推进验证，将持续巩固国产细分龙头地位。

利润方面，2025 年度归母净利润 7170.51 万，同比有所下降，主要由营收增速不高，叠加期间费用增加、政府补助减少等因素所致。

现金流方面，2025 年度经营活动现金流量净额 1.03 亿，同比有所下降，主要由签单持续增长，物料备货采买支出大幅增加，同时人员增加导致支付员工薪酬等支出等增加所致。

签单方面，2025 年新签订单保持较快增长，尤其是新产品化学清洗机，已经全面导入国内多家头部晶圆厂，并获得了部分客户的批量重复性订单，客户对于机台表现的认可度高，采买意愿强烈，预计化学清洗在未来几年仍将保持不错增长。

合同负债方面，2025 年末公司合同负债同比增长超 50%，一定程度上也反映了签单的良好态势。

2026 年第一季度，公司实现营业收入 3.31 亿，同比增长 20%。归母净利润 350.89 万元，同比下降 25%，主要由于公司规模不断扩大导致成本费用增加，叠加政府补助减少造成其他收益减少所致。一季度新签订单同比较高增长，签单态势良好。

整体上看，随着北方华创在 2025 年 6 月成为公司控股股东并全面赋能以来，公司发生了很多新的变化，各方面管理精细度都在稳步提升，公司正持续聚焦主要资源，力争在未来几年实现前道 track 的快速突破。同时，公司也将继续加大前道化学清洗新品的客户端导入力度，并不断巩固在后

道先进封装领域的领先优势，保障未来几年业务持续向好发展。谢谢！

二、互动交流

Q1：展望 2026，公司认为最主要的增长驱动力是什么？是否有新业务或新产品能成为重要的利润增长点？

A1：从半导体设备行业来看，随着下游电子、汽车、通信等行业需求的稳步增长，以及人工智能、云计算及大数据等新兴领域的快速发展，集成电路产业面临着新型芯片带来的产能扩张需求，将持续推动半导体设备的资本开支，带来广阔的市场空间。从公司产品来看，在涂胶显影设备方面，公司将继续紧盯全球光刻工艺发展新趋势，结合公司整体发展战略，继续研发新一代可适应更高光刻机产能的涂胶显影架构；在前道化学清洗设备方面，目前高端产品陆续实现卡位并已经开始放量，订单增速很快，公司将借助北方华创集团赋能，与集团产品协同配合，不断提升在客户端的市占率，提高产品订单及收入规模；在后道产品方面，公司持续推出一系列新产品，如临时键合、解键合以及 frame 清洗等，这两年都有非常好的表现，2025 年收入占比大幅提升。随着客户在 CoWoS、HBM 以及 3DIC 等领域的深化布局，公司后道产品也将持续受益。

Q2：技术创新和产业升级方面有哪些举措？

A2：半导体设备属于高度技术密集型行业，具有极高的技术壁垒和客户准入门槛。公司将提高自主创新能力作为公司发展的第一要务，持续加大研发投入力度，研发费用连续多年保持在营业收入的 10%以上。在涂胶显影相关技术方面，进一步优化单元和整机设计，提高产品的可靠性、稳定性；在前道清洗方面，聚焦化学清洗与干燥技术的深度优化，进一步提升产品的技术等级和应用范围，系统性提升清洗设备产

能；在后道设备方面，研究解决键合、解键合关键技术，推进研发和产业化进程。

Q3：公司如何根据自身优势和市场需求来制定和实施这些发展目标？

A3：公司专注于高端半导体专用设备领域，目前已形成前道涂胶显影设备、前道清洗设备、后道先进封装设备、化合物等小尺寸设备四大业务板块。公司通过持续的技术研发和供应链建设，提升公司的核心竞争力，增强团队的执行力和凝聚力，不断开拓新产品、新领域，有效提升公司收入和利润规模，为股东创造价值。未来公司将积极加强技术人才团队、知识产权和商业秘密体系建设，通过有效的内控和核心竞争力的提升，稳健发展并防范各种风险。

Q4：公开数据显示，近两年来，公司营业收入小幅增长，净利润却持续下滑，2025年扣非净利润首次出现亏损。今年一季度，公司净利润同比下降24.70%，扣非净利润续亏，请问公司近年利润持续下降的原因是什么，是否还有进一步下滑的风险，公司有没有明确的降费增效方案，从费用结构、投产节奏上扭转亏损的现状？前道涂胶显影、化学清洗等主力新产品订单充足但收入确认滞后的周期还要多久落地兑现营收利润？

A4：公司新一代涂胶显影机、高端化学清洗机、先进封装新产品、核心零部件等研发投入及人才储备强度较大。同时，公司新产品订单快速增长，对应投入的管理费用、销售费用持续增加。但公司新产品从研发、获得订单到转化成收入需要一定周期，会有投入产出时间上的错配。另外叠加政府补助未如期到账、汇兑损失等因素，导致利润下滑。公司持续推动信息化、数字化建设，落实精益化、全过程管理，以提高整体运营效率为目标，开展降本增效全员行动计划。2025

	<p>年，化学清洗首次贡献收入，后续随着持续签单及交验节奏加快，预计化学清洗在收入中的占比也将持续提升。公司将继续锚定前道涂胶显影、前道清洗、后道先进封装三大核心主赛道，以客户为中心，持续提升产品竞争力及市场占有率，不断做优做大经营体量。</p> <p>Q5：数据显示，2025 年公司计入损益政府补助近 1 亿元，占公司当期利润总额的 151.19%，扣非净利润亏损超 1800 万元，今年一季度，同样依靠政府补助才实现账面微利，扣非净利润依旧是亏损的，请问当前公司主业盈利能力偏弱，利润靠大额补助托底，是阶段性行业因素还是公司产品盈利模型存在长期隐患？若未来政府补助大幅缩减，是否会对公司持续盈利带来影响？公司将通过哪些举措，实现主营业务经营层面的稳定盈利？</p> <p>A5：公司目前收入规模尚小，且产品综合毛利率相对不高，同时为保障未来发展，持续加大人才引进及研发投入等，未来随着规模的扩大，预计盈利会有所恢复。在公司产品方面，公司将围绕下游客户需求，立足涂胶显影主赛道，持续开展技术研发及产品迭代，加快推进产品成熟化、标准化，持续提升机台稳定性及产能效率，为客户提供更具性价比和竞争力的半导体装备产品及工艺整体解决方案。同时积极培育前道化学清洗、临时键合、解键合、Frame 清洗等多款新产品，开辟新的收入增长点。在供应链建设方面，公司将通过联合开发、自主研发、寻找替代供应商等方式降低核心部件成本，巩固核心部件可控性，持续提升产品综合竞争力。在运营管理方面，逐渐降低销售、管理等费用率，优化运营管理，提高经营质效。</p>
附件清单	无

本次活动是否涉 及应当披露重大 信息	不涉及
--------------------------	-----